

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第1部門第2区分
 【発行日】令和7年7月14日(2025.7.14)

【国際公開番号】WO2023/285608
 【公表番号】特表2024-527289(P2024-527289A)
 【公表日】令和6年7月24日(2024.7.24)
 【年通号数】公開公報(特許)2024-137
 【出願番号】特願2023-579173(P2023-579173)
 【国際特許分類】

10

A 6 1 M 27/00(2006.01)

【FI】

A 6 1 M 27/00

【手続補正書】

【提出日】令和7年7月4日(2025.7.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

創傷をカバーし、創傷上にシールを形成するように構成されたカバー層と、
 電子組立品と、
 を備え、
 前記電子組立品が、

陰圧源を含む電子ユニットであって、前記陰圧源が、本体部分と、前記本体部分から延在する入口と、を備え、前記入口が、第二の端部の反対側の第一の端部を備え、前記第二の端部が、前記本体部分に取り付けられる、電子ユニットと、

30

複数の可撓性フィルム層を含むハウジングであって、前記電子ユニットが、前記複数の可撓性フィルム層内に少なくとも部分的に囲い込まれ、前記複数の可撓性フィルム層が、第一の可撓性フィルム層および第二の可撓性フィルム層を含み、前記第一および第二の可撓性フィルム層が、前記第一および第二の可撓性フィルム層の各々の周囲に沿って一緒に接合されて、前記第一および第二の可撓性フィルム層の間に前記電子ユニットを少なくとも部分的に囲い込み、前記第一の可撓性フィルム層が、前記入口を受容し、前記入口の周りに密封シールを形成して、創傷滲出液が前記電子ユニット内に入るのを防止するように構成されたアパーチャを備える、ハウジングと、
 を備え、

前記カバー層が、前記電子組立品を受容するように構成された開口部を含む、創傷被覆材装置。

40

【請求項2】

前記入口の前記第一の端部が第一の直径を備え、

前記入口の前記第二の端部が第二の直径を備える、請求項1に記載の創傷被覆材装置。

【請求項3】

前記第二の端部の前記第二の直径が、前記入口が前記第二の端部から前記第一の端部に先細りするよう、前記第一の端部の前記第一の直径よりも大きい、請求項2に記載の創傷被覆材装置。

【請求項4】

近位の創傷に面する面および遠位面を含む創傷接触層であって、前記近位の創傷に面す

50

る面が、前記創傷と接触して位置付けられるように構成された創傷接触層と、
前記創傷接触層上の少なくとも一つの吸収層と、
をさらに備え、

前記カバー層が、前記創傷接触層と前記少なくとも一つの吸収層とをカバーし、それらの上にシールを形成するよう構成され、

前記少なくとも一つの吸収層が、前記電子組立品を受容するように構成された凹部を含む、請求項 1 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 5】

前記電子ユニットが、

前記陰圧源の出口上に位置付けられた出口または排気機構であって、前記陰圧源から排出される空気を排出するように構成されたベント開口部を備える、出口または排気機構と、

可撓性回路基板であって、センサ、スイッチ、通気孔、および/または、光もしくは LED インジケータのうちの一つ以上を備える可撓性回路基板と、
をさらに備える、請求項 1 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 6】

前記第一の可撓性フィルム層が、前記回路基板上の前記センサと整列するように構成された第二のアーチャを備え、前記センサが、前記陰圧源の前記入口からの圧力を測定するように構成されており、

任意で、

前記創傷被覆材装置が、前記第二のアーチャと前記第一のセンサとの間に位置付けられるように構成されたフィルタをさらに備える、請求項 5 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 7】

前記第一の可撓性フィルム層および前記第二の可撓性フィルム層が、防水および/または気密フィルム材料を含む、請求項 1 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 8】

前記第一の可撓性フィルム層および前記第二の可撓性フィルム層が、ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン、ポリエステル、エチレンビニルアセテート、またはポリエチレンを含む、請求項 1 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 9】

前記第一の可撓性フィルム層および前記第二の可撓性フィルム層が、蒸気が前記第一および第二の可撓性フィルム層を通過することを可能にするように構成された透湿性を有する材料を含む、請求項 1 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 10】

前記ハウジングが、前記電子組立品用のラベルを形成する材料層を含む上部ハウジング部分をさらに備え、

前記上部ハウジング部分が、第一の創傷に面する側および反対側の第二の側を備え、

前記第二の可撓性フィルム層が、前記上部ハウジング部分の前記第一の側に接合される、請求項 1 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 11】

創傷被覆材装置であって、

創傷をカバーし、創傷上にシールを形成するよう構成されたカバー層と、

電子組立品と、

を備え、

前記電子組立品が、

陰圧源を含む電子ユニット、および

ハウジングと、

を備え、

前記ハウジングが、

第一の創傷に面する表面および反対側の第二の表面を含む、下部可撓性フィルム層と、

10

20

30

40

50

第一の創傷に面する表面および反対側の第二の表面を含む上部ハウジング部分であって、前記上部ハウジング部分の前記第一の表面の周縁部に沿ったコーティングを含む、上部ハウジング部分と、
を含み、

前記電子ユニットが、前記可撓性フィルム層および前記上部ハウジング部分内に少なくとも部分的に囲い込まれ、

前記可撓性フィルム層が、前記可撓性フィルム層の周縁部に沿って前記上部ハウジング部分の前記コーティングに接合されて、前記可撓性フィルム層と前記上部ハウジング部分との間に前記電子ユニットを少なくとも部分的に囲い込み、

前記カバー層が、前記電子組立品を受容するように構成された開口部を含む、創傷被覆材装置。 10

【請求項 1 2】

前記可撓性フィルム層が、熱および/または圧力を通して前記上部ハウジング部分の前記コーティングに接合される、請求項 1 1 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 1 3】

回路基板を、さらに備え、

前記回路基板が、排気孔と、第一の創傷に面する表面と、反対側の第二の表面と、を備える、請求項 1 1 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 1 4】

前記上部ハウジング部分の前記コーティングが、第一のコーティングを備え、 20

前記回路基板が、前記回路基板の前記第二の表面の周縁部に沿って第二のコーティングを備え、

前記第一のコーティングが、前記可撓性フィルム層の周縁部、および前記回路基板上の前記第二のコーティングに接合または封止される、請求項 1 3 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 1 5】

前記上部ハウジング部分の前記コーティングが、第一のコーティングを備え、

前記上部ハウジング部分が、前記上部ハウジング部分の前記第一の表面上に第二のコーティングを備え、

前記第二のコーティングが、前記上部ハウジング上部の排気孔を囲み、

前記回路基板が、前記回路基板の前記第二の表面上に第三のコーティングを備え、 30

前記第三のコーティングが、前記回路基板の前記排気孔を囲み、

前記上部ハウジング部分の前記第二のコーティングが、前記回路基板上の前記第三のコーティングに接合される、請求項 1 3 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 1 6】

前記上部ハウジング部分の前記コーティングが、第一のコーティングを備え、

前記上部ハウジング部分が、前記上部ハウジング部分の前記第一の表面上に第二のコーティングを備え、

前記第二のコーティングが、前記上部ハウジング部分の排気孔を囲み、

前記回路基板が、前記回路基板の前記第二の表面上に第三のコーティングを備え、

前記第三のコーティングが、前記回路基板の前記排気孔を囲み、 40

前記回路基板が、前記回路基板の前記第二の表面の周縁部に沿って第四のコーティングを備え、

前記上部ハウジング部分の前記第二のコーティングが、前記回路基板上の前記第三のコーティングに接合され、

前記第一のコーティングが、前記可撓性フィルム層の周縁部および前記回路基板の前記第四のコーティングに接合される、請求項 1 3 に記載の創傷被覆材装置。

【請求項 1 7】

前記陰圧源が、本体部分と、前記本体部分から延在する入口と、を備え、

前記入口が、第二の端部の反対側の第一の端部を備え、

前記第二の端部が、前記本体部分に取り付けられる、請求項 1 1 に記載の創傷被覆材装 50

置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 2 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 2 8】

本開示の範囲は、本節におけるまたは本明細書の他の箇所における好ましい実施形態の特定の開示によって制限されることを意図するものではなく、本節においてもしくは本明細書の他の箇所において提示されるか、またはこの後に提示される特許請求の範囲によって定義され得る。本特許請求の範囲の文言は、本特許請求の範囲で用いられている文言に基づいて広い意味で解釈されるべきであり、本明細書に記載される例または本出願の手続き中に記載される例に限定されるものではなく、それらの例は、非排他的なものとして解釈されるべきである。

10

____ [付記項 1]

____ 創傷被覆材装置であって、

____ 創傷をカバーし、創傷上にシールを形成するように構成されたカバー層と、

____ 電子組立品であって、

____ 陰圧源を含む電子ユニットであって、前記陰圧源が、本体部分と、前記本体部分から延在する入口と、を備え、前記入口が、第二の端部の反対側の第一の端部を備え、前記第二の端部が、前記本体部分に取り付けられる、電子ユニット、および、

20

____ 複数の可撓性フィルム層を含むハウジングであって、前記電子ユニットが、前記複数の可撓性フィルム層内に少なくとも部分的に囲い込まれ、前記複数の可撓性フィルム層が、第一の可撓性フィルム層および第二の可撓性フィルム層を含み、前記第一および第二の可撓性フィルム層が、前記第一および第二の可撓性フィルム層の各々の周囲に沿って一緒に接合されて、前記第一および第二の可撓性フィルム層の間に前記電子ユニットを少なくとも部分的に囲い込み、前記第一の可撓性フィルム層が、前記入口を受容し、前記入口の周りに密封シールを形成して、創傷滲出液が前記電子ユニット内に入るのを防止するように構成されたアパーチャを備える、ハウジング、を備える、電子組立品と、を含み、

____ 前記カバー層が、前記電子組立品を受容するように構成された開口部を含む、創傷被覆材装置。

30

____ [付記項 2]

____ 前記入口の前記第一の端部が第一の直径を備え、前記入口の前記第二の端部が第二の直径を備える、付記項 1 に記載の創傷被覆材装置。

____ [付記項 3]

____ 前記第二の端部の前記第二の直径が、前記入口が前記第二の端部から前記第一の端部に先細りするように、前記第一の端部の前記第一の直径よりも大きい、付記項 2 に記載の創傷被覆材装置。

____ [付記項 4]

____ 近位の創傷に面する面および遠位面を含む創傷接触層であって、前記近位の創傷に面する面が、前記創傷と接触して位置付けられるように構成された創傷接触層と、

40

____ 前記創傷接触層上の少なくとも一つの吸収層と、をさらに備え、

____ 前記カバー層が、前記創傷接触層と前記少なくとも一つの吸収層とをカバーし、それらの上にシールを形成するよう構成され、

____ 前記少なくとも一つの吸収層が、前記電子組立品を受容するように構成された凹部を含む、付記項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の創傷被覆材装置。

____ [付記項 5]

____ 前記電子ユニットが、

____ 前記陰圧源の出口上に位置付けられた出口または排気機構であって、前記陰圧源から排出される空気を排出するように構成されたベント開口部を備える、出口または排気機構と

50

可撓性回路基板であって、センサ、スイッチ、通気孔、および/または、光もしくはLEDインジケータのうちの一つ以上を備える可撓性回路基板と、をさらに備える、付記項1～4のいずれか一項に記載の創傷被覆材装置。

[付記項6]

前記第一の可撓性フィルム層が、前記回路基板上の前記センサと整列するように構成された第二のアーチャを備え、前記センサが、前記陰圧源の前記入口からの圧力を測定するように構成される、付記項5に記載の創傷被覆材装置。

[付記項7]

前記第二のアーチャと前記第一のセンサとの間に位置付けられるように構成されたフィルタをさらに備える、付記項6に記載の創傷被覆材装置。

10

[付記項8]

前記第一の可撓性フィルム層および前記第二の可撓性フィルム層が、防水および/または気密フィルム材料を含む、付記項1～7のいずれか一項に記載の創傷被覆材装置。

[付記項9]

前記第一の可撓性フィルム層および前記第二の可撓性フィルム層が、ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン、ポリエステル、エチレンビニルアセテート、またはポリエチレンを含む、付記項1～8のいずれか一項に記載の創傷被覆材装置。

[付記項10]

前記第一の可撓性フィルム層および前記第二の可撓性フィルム層が、蒸気が前記第一および第二の可撓性フィルム層を通過することを可能にするように構成された透湿性を有する材料を含む、付記項1～9のいずれか一項に記載の創傷被覆材装置。

20

[付記項11]

前記ハウジングが、前記電子組立品用のラベルを形成する材料層を含む上部ハウジング部分をさらに備え、前記上部ハウジング部分が、第一の創傷に面する側および反対側の第二の側を備え、前記第二の可撓性フィルム層が、前記上部ハウジング部分の前記第一の側に接合される、付記項1～10のいずれか一項に記載の創傷被覆材装置。

[付記項12]

創傷被覆材装置であって、
創傷をカバーし、創傷上にシールを形成するように構成されたカバー層と、
電子組立品であって、
陰圧源を含む電子ユニット、および
ハウジングであって、

30

第一の創傷に面する表面および反対側の第二の表面を含む、下部可撓性フィルム層と、
第一の創傷に面する表面および反対側の第二の表面を含む上部ハウジング部分であって、前記上部ハウジング部分の前記第一の表面の周縁部に沿ったコーティングを含む、上部ハウジング部分と、を含み、

前記電子ユニットが、前記可撓性フィルム層および前記上部ハウジング部分内に少なくとも部分的に囲い込まれ、

前記可撓性フィルム層が、前記可撓性フィルム層の周縁部に沿って前記上部ハウジング部分の前記コーティングに接合されて、前記可撓性フィルム層と前記上部ハウジング部分との間に前記電子ユニットを少なくとも部分的に囲い込む、ハウジング、を含む、電子組立品と、を備え、

40

前記カバー層が、前記電子組立品を受容するように構成された開口部を含む、創傷被覆材装置。

[付記項13]

前記可撓性フィルム層が、熱および/または圧力を通して前記上部ハウジング部分の前記コーティングに接合される、付記項12に記載の創傷被覆材装置。

[付記項14]

排気孔と、第一の創傷に面する表面と、反対側の第二の表面と、を備える回路基板を、

50

さらに備える、付記項 1 2 ~ 1 3 に記載の創傷被覆材装置。

____ [付記項 1 5]

前記上部ハウジング部分の前記コーティングが、第一のコーティングを備え、前記回路基板が、前記回路基板の前記第二の表面の周縁部に沿って第二のコーティングを備え、前記第一のコーティングが、前記可撓性フィルム層の周縁部、および前記回路基板上の前記第二のコーティングに接合または封止される、付記項 1 4 に記載の創傷被覆材装置。

____ [付記項 1 6]

前記上部ハウジング部分の前記コーティングが、第一のコーティングを備え、前記上部ハウジング部分が、前記上部ハウジング部分の前記第一の表面上に第二のコーティングを備え、前記第二のコーティングが、前記上部ハウジング上部の排気孔を囲み、前記回路基板が、前記回路基板の前記第二の表面上に第三のコーティングを備え、前記第三のコーティングが、前記回路基板の前記排気孔を囲み、前記上部ハウジング部分の前記第二のコーティングが、前記回路基板上の前記第三のコーティングに接合される、付記項 1 4 に記載の創傷被覆材装置。

10

____ [付記項 1 7]

前記上部ハウジング部分の前記コーティングが、第一のコーティングを備え、前記上部ハウジング部分が、前記上部ハウジング部分の前記第一の表面上に第二のコーティングを備え、前記第二のコーティングが、前記上部ハウジング部分の排気孔を囲み、前記回路基板が、前記回路基板の前記第二の表面上に第三のコーティングを備え、前記第三のコーティングが、前記回路基板の前記排気孔を囲み、前記回路基板が、前記回路基板の前記第二の表面の周縁部に沿って第四のコーティングを備え、前記上部ハウジング部分の前記第二のコーティングが、前記回路基板上の前記第三のコーティングに接合され、前記第一のコーティングが、前記可撓性フィルム層の周縁部および前記回路基板の前記第四のコーティングに接合される、付記項 1 4 に記載の創傷被覆材装置。

20

____ [付記項 1 8]

前記陰圧源が、本体部分と、前記本体部分から延在する入口と、を備え、前記入口が、第二の端部の反対側の第一の端部を備え、前記第二の端部が、前記本体部分に取り付けられる、付記項 1 2 ~ 1 7 のいずれかに記載の創傷被覆材装置。

____ [付記項 1 9]

前記可撓性フィルム層が、前記入口を受容し、前記入口の周りに密封シールを形成して、創傷滲出液が前記電子ユニット内に入るのを防止するように構成されたアパーチャを備える、付記項 1 8 に記載の創傷被覆材装置。

30

____ [付記項 2 0]

前記コーティングが、分散コーティングを含む、付記項 1 2 ~ 1 9 のいずれかに記載の創傷被覆材装置。

____ [付記項 2 1]

前記コーティングが、ポリウレタン (P U) 分散コーティングを含む、付記項 1 2 ~ 2 0 のいずれかに記載の創傷被覆材装置。

____ [付記項 2 2]

付記項 1 ~ 2 1 のいずれかに記載の創傷被覆材装置を使用または操作する方法。

40

____ [付記項 2 3]

上記の説明に記載された特徴のうちの一つ以上を含む、創傷被覆材装置。

____ [付記項 2 4]

上記の説明に記載された一つ以上の特徴を含む、創傷被覆材装置を使用または操作する方法。

____ [付記項 2 5]

上記の説明に記載された特徴のうちの一つ以上を含む、電子組立品。

50